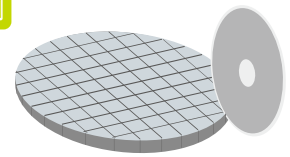


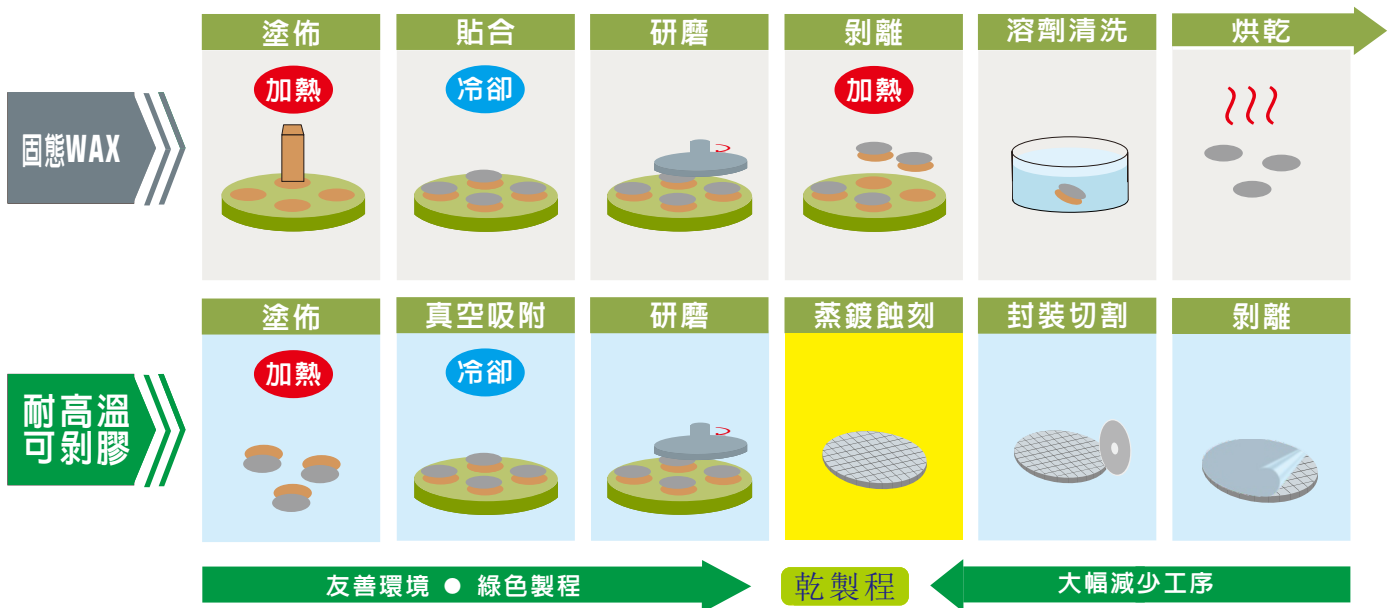
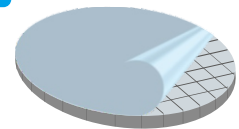
Intelliion® 耐高溫可剝性暫時固定處理劑

- 友善環境(不使用有機溶劑)
- 提升作業效率並節省費用(剝離後省略洗淨工程)
- 具優異的附著性能提高加工精度
- 極優異的耐酸鹼化學性
- 極佳的保護性且剝離後不會殘膠
- 非常良好的耐熱性，可提供更多元的應用選項

晶片元件切割



無應力剝離



規格

		5500系列	5510系列	5520系列	5530系列	5540系列
塗佈方式	Silk screen	X	◎	◎	◎	◎
	Spin, Dipping, Coater	◎	X	◎	◎	◎
固化方式	自然乾燥	X	X	◎	X	X
	熱風乾燥	◎	◎	◎	◎	◎
剝離方式	溶劑浸泡	○ / ◎	○ / ◎	◎	○ / ◎	○ / ◎
	手動剝離	○ / ◎	○ / ◎	◎	○ / ◎	X
	滾輪剝離	○ / ◎	○ / ◎	◎	○ / ◎	X
適用素材	Wafer	◎	◎	◎	◎	◎
	強化玻璃	◎	◎	◎	◎	◎
	SUS	◎	◎	◎	◎	◎
	陶瓷	◎	◎	◎	◎	◎
	SIC	◎	◎	◎	◎	◎
耐熱性	200°C/250°C	200°C/250°C	150°C	250°C/300°C	120°C/320°C	
鉛筆硬度	—	—	—	—	4H	